证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-012

深圳英集芯科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200.00万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	110,264,999.82
减：银行手续费	1,321.11
减：募投项目支出金额	318,266,818.38
减：超募资金永久补充流动资金金额	528,820,544.96
减：补充流动资金	60,000,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	36,435,176.13
加：利息收入	36,128,860.40
募集资金专户余额	0.00

2025年度，公司募集资金项目投入0.00元、使用超募资金永久补充流动资金78,820,544.96元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金1,017,660,000.00元（抵扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、管理、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已于2022年3月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	账户状态
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000360384	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
招商银行股份有限公司深圳分行	755953765610601	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211225889370600002	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	219227798887500003	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211227798887500002	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	226225889370600004	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	228227798887500003	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	220227798887500002	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
合计		0.00		/

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）220227798887500002是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211227798887500002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户全部已注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况

2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

2025年4月16日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2025年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年6月，公司将到期的现金管理收回后用于永久补流。截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金无现金管理余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司实际募集资金净额为人民币90,739.50万元，超募资金总额为人民币50,670.77万元。

2022年5月10日，公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。

2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。

2024年4月25日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-026）。

2025年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.15%。（具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-023）。

截至2025年12月31日，公司累计使用52,882.05万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0336）。报告认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了英集芯公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：截至2025年12月31日，英集芯募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年度）

单位：人民币/元

募集资金总额	1,017,660,000.00	本年度投入募集资金总额	78,820,544.96
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	907,087,363.34
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)注1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
电源管理芯片开发和产业化项目	是	185,584,400.00	185,584,400.00	185,584,400.00	0.00	184,549,360.80	-1,035,039.20	99.44	2024年11月	不适用	不适用	否
快充芯片开发和产业化项目	是	155,102,900.00	155,102,900.00	155,102,900.00	0.00	133,717,457.58	-21,385,442.42	86.21	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目投资小计	-	400,687,300.00	400,687,300.00	400,687,300.00	0.00	378,266,818.38	-22,420,481.62 注2	-	-		-	-
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金注3		506,707,700.18	506,707,700.18	506,707,700.18	78,820,544.96	528,820,544.96	22,112,844.78 注3	104.36	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		506,707,700.18	506,707,700.18	506,707,700.18	78,820,544.96	528,820,544.96	22,112,844.78 注3	104.36	-	-	-	-
合计	-	907,395,000.18	907,395,000.18	907,395,000.18	78,820,544.96	907,087,363.34	-307,636.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2025年度内本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。 2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 2025年4月16日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2025年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。 截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金无现金管理余额。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。 2024年4月25日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-026）。 2025年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.15%。（具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-023）。截至2025年12月31日，公司累计使用52,882.05万元超募资金用于补充流动资金。 截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额的合计金额”未包含超募资金部分，2024年12月10日，公司审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年12月31日，本次节余募集资金实际转出3,643.52万元，其中募投项目本金结余2,242.05万元，利息及现金管理收益（扣除手续费）结余1,401.47万元。

注3：“超募资金永久补充流动资金”中截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额的原因系使用超募资金永久补充流动资金的金额含超募资金形成的利息收入。

公司代码：688209　　公司简称：英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为177,974,383.61元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为529,946,351.06元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

截至本报告披露日，公司总股本433,784,049股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4,369,283股后的股本429,414,766股为基数，以此计算合计派发现金红利26,623,715.49元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的14.96%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英集芯	688209	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴任超	陈文琪
联系地址	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
电话	0756-3393868	0756-3393868
传真	0756-3393801	0756-3393801
电子信箱	zqb@injoinic.com	zqb@injoinic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

2.1.1 主要业务情况

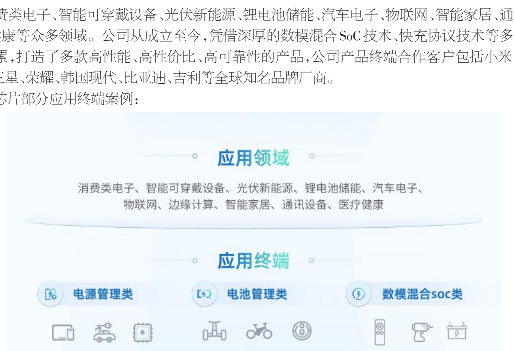
随着公司产品在新应用领域的不断拓展，产品结构持续优化，原有产品分类已不能体现公司当前业务发展情况，报告期内，公司在原有电源管理芯片和快充协议芯片主要产品基础上进行重新分类，将核心产品主要划分为“电源管理类”“数模混合SoC类”“电池管理类”和“其他”等四大分类，具体情况如下：

公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的高新技术企业，主营业务聚焦于电源管理、电池管理、数模混合SoC等相关芯片的研发、设计与应用。公司围绕着智能电子设备的能源供应、电池安全管控、系统控制及多元功能实现，为消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、汽车电子、物联网、智能家居、通讯设备、医疗健康等众多领域，提供涵盖能源转换、电池保护、协议适配、功能控制等全流程的芯片产品及解决方案。

2.1.2 主要产品情况

公司的主要产品为电源管理芯片类、电池管理芯片类、数模混合SoC芯片类等系列芯片，其广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、汽车电子、物联网、智能家居、通讯设备、医疗健康等众多领域。公司从成立至今，凭借深厚的数模混合SoC技术、快充协议技术等多项核心技术积累，打造了多款高性能、高性价比、高可靠性的产品，公司产品终端合作客户包括小米、OPPO、vivo、三星、荣耀、韩国现代、比亚迪、吉利等全球知名品牌厂商。

公司芯片部分应用终端案例：


应用领域
消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、汽车电子、物联网、边缘计算、智能家居、通讯设备、医疗健康
应用终端
电源管理类
电池管理类
数模混合soc类

2.1.3 公司核心产品：

（1）电源管理芯片类：作为能源适配与调控的关键，涵盖移动电源芯片、ACDC芯片、TWS耳机充电仓芯片、PMIC芯片、车规芯片、无线充芯片、LED驱动芯片等产品，这类产品具备高效电能转换、智能功率分配、多重安全防护等特点，确保各类电子设备稳定供电与功能实现。

（2）电池管理芯片类：专注锂电池全周期管理，包含锂电池充放电、锂电池保护、电量计等芯片；通过精准管控电池充放电状态、保障电池安全，延长电池使用寿命，为电动工具、便携式储能设备等依赖锂电池的产品筑牢能源根基。

（3）数模混合SoC芯片类：承担设备系统控制与多元功能协同职责，有快充协议芯片、MCU芯片、电机驱动芯片、蓝牙芯片等芯片。凭借协议适配、智能控制、动力驱动、无线连接等能力，支撑智能设备高效运作与交互体验。

（4）其他芯片：拓展芯片应用边界，包含音频芯片、信号链芯片相关产品，为消费电子音频体验升级、工业检测等场景信号处理，提供技术支撑，丰富芯片应用生态。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用Fabless的经营模式，主要从事芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。在此模式下，有助于公司深耕研发创新，聚焦行业发展新动态，推出性能优良、竞争力强的产品。

2.2.1 研发模式

公司始终将芯片的设计研发作为公司运营活动的核心。公司紧密跟随市场的变化趋势，将市场动态与客户需求通过一系列研发工作转化成性能优良、竞争力强的产品，并不断进行产品更新迭代，拓展产品的应用领域，以满足不断发展的市场需求。

公司的产品研发按照公司规定的流程严格管控，具体研发流程包括项目立项、方案开发、项目开发、项目验证（样片测试）、项目量产、项目结项等阶段。

2.2.2 采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售，通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试，公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动，灵活高效等特点。

在Fabless模式中，公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前，公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

2.2.3 销售模式

公司目前采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端厂商直接销售产品。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1) 所处行业

公司主营业务是电源管理系列芯片、电池管理系列芯片、数模混合SoC等相关芯片的研发和销售。公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。

2) 行业发展情况

① 全球半导体行业发展态势

在全球数字化转型的大趋势下，半导体行业作为信息技术产业的基石，正处于快速发展阶段。随着5G通信、物联网、人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用，半导体芯片的市场需求呈现出爆发式增长。根据WSTS数据，2025年全球半导体销售额同比增长25.6%至7,917亿美元，预估2026年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3%，实现9,750亿美元。公司所处的电源管理芯片及快充协议芯片细分领域，因各类智能设备对高效电源管理和快速充电功能的需求不断提升，迎来了广阔的发展空间。

② 我国半导体产业发展现状

我国作为全球最大的半导体消费市场，半导体产业发展迅速。但在高端芯片技术方面，仍与国际先进水平存在一定差距，高端芯片进口依赖度较高，这为国内半导体企业在中低端市场及部分新兴应用领域的发展提供了机遇。在电源管理芯片领域，国内企业不断加大研发投入，技术水平逐步提升，市场份额也在稳步扩大。根据SIA数据，2025年中国半导体销售额首次突破2,000亿美元，超过2100亿美元，同比增速超过15%，占全球总额约三成，数据表明我国半导体技术实力在不断增强。公司凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势，在国内电源管理芯片和快充协议芯片市场占据了一定地位。

③ 国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业意义重大，已上升为国家战略，国家接连出台诸多支持政策。如2020年7月国务院发布的政策，从财税、投融资等八方面扶持集成电路企业；2021年3月的“十四五”规划等将集成电路列为重点攻关产业；党的二十大报告强调推动相关新兴产业融合发展；2024年7月中共中央决定强化集成电路等重点产业链发展。2025年11月的“十五五”规划明确提出“全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。公司作为集成电路领域企业，这些政策为其带来发展契机。

④ 行业的发展机遇

近年来，随着生成式AI、新能源汽车、5G、物联网、可穿戴医疗设备等新兴技术的持续发力，各类智能设备、物联网终端、数据中心等对电源管理芯片、电池管理芯片和快充协议芯片的需求持续攀升，为电源管理、快充协议及电池管理芯片等细分市场带来机遇。在这一发展趋势下，这些新兴应用领域对芯片的性能、功耗、集成度等方面提出了更高要求，为公司提供了广阔的市场空间。例如，在物联网设备中，需要低功耗、高可靠性的电源管理芯片来延长设备续航时间；在5G基站中，需要高效的电源管理芯片来降低能耗。公司可以凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势，开发出满足这些新兴应用需求的产品。

电源管理芯片作为电子设备的“能量心脏”，在消费电子等众多领域中扮演着不可或缺的角色。在供应链安全与自主可控的国家战略指引下，下游消费电子对国产高性能电源管理芯片的验证和导入意愿显著增强，高端产品国产化进程将受益于增量市场空间爆发。

电池管理类芯片作为电动工具、智能家电等领域的核心组件，凭借其精准电量监测、高效充放电控制、安全保护等特性，保障电池系统的稳定运行。近年来，全球电池管理芯片市场受益于电池安全需求不断提升，整体呈现高速增长态势。在电子产品安全保护推动下，国内电池管理芯片市场需求持续旺盛，尤其在低功耗、高集成度、小型化的消费级电池管理芯片领域，国产替代需求迫切。

快充协议芯片是消费电子快充设备等场景的主要器件，负责实现快充协议适配、功率调节及安全保护等功能。近年来，全球快充设备市场规模持续扩张，PD3.1、UFCS等新一代快充标准普及，推动快充协议芯片向高功率、多协议兼容、高集成度方向发展。中国手机品牌引领全球快充技术迭代，inbox充电器、便携式储能设备等设备对快充协议芯片的需求大幅增加。在供应链自主可控趋势下，下游手机品牌、消费电子厂商对国产快充协议芯片的验证和导入意愿显著增强，公司在大功率快充、新国标移动电源等领域占据相对优势地位，未来将持续受益于快充市场的快速增长。

同时，由于集成电路产业外部环境的复杂和不确定性，我国加快了半导体产业国产替代的步伐。政府出台了一系列政策支持国内半导体企业发展，包括税收优惠、研发补贴、产业基金扶持等。在这种背景下，国内下游企业对国产芯片的接受度逐渐提高，优先选择本土供应商，有利于为公司提供良好的市场机遇。国内通信设备制造商、消费电子品牌等企业在采购芯片时，开始加大对国产芯片的采购比例，公司可以抓住这一机遇，进一步扩大市场份额。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于高性能、高品质的数模混合芯片设计。自成立以来，经过公司不断的研发和创新，在数模混合SoC集成技术、快充接口协议全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度ADC和电量计技术、大功率升降压技术、微型声重放系统等方面拥有深厚的技术积累。公司推出的电源管理芯片具有高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点，能够缩短客户成品方案研发周期，简化客户产品生产过程，提升产品良率和可靠性，从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。产品受到了市场和行业的广泛认可。公司的快充协议芯片具有较强的市场竞争力，是获得全球首个QC5.0认证，首批Vooc SuperVooc授权厂商，取得PD认证芯片品类较多的厂商。因此，公司成为了消费电子市场主要的电源管理芯片和快充协议芯片供应商之一。报告期内产生销售收入的产品型号超过500款，对应的产品子型号数量超过5600个，芯片销售数量超过20亿颗。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO、vivo及三星等知名厂商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1) 电源管理芯片领域

电源管理芯片堪称电子设备的“电能管家”，在各类电子产品中负责电能的变换、分配、检测及管理等关键任务，其性能优劣直接关乎电子设备的整体表现。如今，电源管理芯片凭借着广阔的终端应用领域，已然成为模拟芯片市场中最为重要的细分领域之一。近年来，随着芯片技术的创新与提升，应用范围还在持续扩张，不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域，更在人工智能、物联网、无线充电、新能源、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。终端应用的拓展推动着电源管理芯片向前发展，将促使厂商对电源管理芯片产生更大的需求，进一步拓宽电源管理芯片市场，为产业带来发展的新机遇。

① 移动电源市场

近年来，移动电源已成为消费者日常不可或缺的电子设备续航产品。然而，行业安全隐患也逐步凸显。据2025年国家市场监管总局专项抽查数据，移动电源产品不合格率高达43.6%，安全隐患问题突出；民航领域因移动电源起火、冒烟引发的安全事故频发，不仅直接威胁消费者生命财产安全，更对公共航空安全构成严峻挑战，行业安全治理迫在眉睫。

为整治这一行业乱象问题，工业和信息化部组织中国电子技术标准化研究院牵头起草《移动电源安全技术规范》（以下简称“新国标”）这一强制性国家标准制修订计划项目的意见，该强制性国家标准计划于2027年4月1日起实施。新国标将全面取代原有GB31241、GB4943.1两项通用标准，成为移动电源安全认证的核心依据。这也意味着新业态下的移动电源行业，将迎来从“功能型”向“安全智能型”的重大升级。此次新国标是以强制形式开展，其对充电宝整机结构、线路板设计、电芯与电池组提出更严苛的安全要求，并新增智能监测、信息标识和寿命管理等条款，被业界视作“史上最严移动电源标准”。

在新国标的推动下，作为移动电源芯片方案的主要供应商，公司将围绕移动电源新国标的标准，发挥公司技术优势，拓展出更多符合新国标的移动电源，为移动电源行业安全发展贡献出一份力量。

② 汽车电源管理市场

汽车行业正在不断向“电动化”和“智能化”发展，随着新能源电动汽车市场渗透率持续提升以及智能驾驶逐步向高阶演进，在上述趋势推动下，相较于传统燃油车，新能源汽车智能化水平已成为整车差异化竞争的关键。消费者对车载娱乐需求的日益增长以及技术创新的不断推进，特别是在车联网、人工智能等技术的加持下，车载信息娱乐系统正逐步实现智能化升级，行业规模呈现稳步增长的态势。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2025年，我国汽车产销量均突破3400万辆，再创历史新高。新能源汽车产销量均超1600万辆，新能源汽车国内新车销量占比突破50%。新能源汽车的快速发展，更是带动了对汽车电源管理芯片的需求。与此同时对车载电源管理芯片的需求度会逐渐增加，这也将带动单辆汽车芯片价值量提升，汽车电源管理领域也会逐渐拓宽，新能源汽车电源管理市场前景广阔。

③ 无线充电市场

近年来，随着技术迭代和消费者需求的变化，电子产品的充电需求逐渐附加技术、场景等多样性特征，无线充电技术应运而生。无线充电技术不需要匹配消费电子的充电插口型号，使用方便，极大满足了消费者的需求，市场规模得以稳步扩张。目前，无线充电技术主要应用在智能手机、笔记本电脑，可穿戴设备和厨房电器等电子设备，未来无线充电的应用进一步拓展至家具、家电、电动汽车等领域。根据中研普华产业研究院预测，到2029年，中国无线充电市场规模有望达到380亿元左右，2024至2029年年复合增长率为23%。

④ TWS耳机市场

全球消费电子正加速向无线化、智能化转型，真无线降噪蓝牙耳机凭借无线便携、主动降噪等核心优势，适配通勤、办公、运动等多元场景，精准解决嘈杂环境听觉干扰痛点，成为音频设备领域增长最快的细分品类。随着蓝牙技术升级、降噪算法迭代与续航能力提升，产品已从基础功能向体验升级跨越，成长为消费电子核心刚需产品。未来，随着AI技术与生物传感器的深度融合，TWS耳机将在音质、续航持续升级的基础上，拓展运动监测、心率检测等功能，构建移动健康监测新生态。

2) 电池管理芯片领域

电池管理（BMS）芯片是电子设备中实现电池安全、高效运行的核心组件，其核心功能包括电压调节、电流控制、温度监测及电量估算等。随着便携式设备及储能系统的普及，这类芯片的技术迭代速度显著加快，尤其在高温环境适应性、多输出通道管理及高集成度封装方面成为行业关注焦点。

① BMS市场

受益于快充技术的迅速发展，智能家居、便携式储能的产品持续放量，BMS作为关键的核心部件，需要更高的性能和可靠性。根据新思界产业研究中心发布的《2026-2030年全球及中国BMS芯片行业研究及十五五规划分析报告》显示，2025年全球BMS芯片市场规模约为400亿元，预计未来全球市场规模将持续扩大，2026-2030年期间年复合增长率CAGR将为8%。在当下，BMS的创新与升级，将开拓出潜力巨大的市场机遇。

② 储能市场

在全球能源短缺以及双碳目标的背景下，传统能源向清洁能源转型成为全球共识，目前全球已有130多个国家和地区相继提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，实现绿色可持续发展已经成为全世界的广泛共识。随着我国“双碳”目标的快速推进，储能领域作为实现能源转型的关键环节，迎来了高速增长的黄金时期。储能系统在电力调峰、可再生能源消纳等方面发挥着重要作用，而电源管理芯片作为储能系统的核心组件，能够精准控制电池的充放电过程，提高能源利用效率，延长电池使用寿命。根据博研咨询发布的《2026年中国锂电池BMS保护板行业市场规模及投资前景预测分析报告》显示，2025年中国储能BMS市场规模已达124亿元，同比增长39.3%，且该统计口径仅限于储能BMS市场，暂未算动力电池BMS、消费电子BMS。未来随着储能市场规模的不断扩大，电池管理芯片在该领域的应用前景十分广阔。

3) 数模混合SoC芯片领域

数模混合SoC芯片融合数字与模拟技术，涵盖快充协议芯片、电机驱动芯片等核心产品，是设备间协议交互的核心载体。报告期内该领域新技术持续突破，AIPC、电动工具、智能家居等新产业崛起，消费电子快充、智能家居交互等新业态升级，“芯片+解决方案”的新模式成为行业发展主流。

① 快充电源适配器市场

随着人工智能、物联网、5G通信等新兴技术的快速发展，电源适配器也朝着小型化、智能化、新兴智能化方向发展。在便携式电子设备普及的背景下，用户对便携性需求不断提升，氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等新型半导体材料的应用，将推动适配器向更小体积、更高功率密度升级，进一步提升携带与使用的便利性及高效性；同时，行业逐步向智能化方向发展，通过集成智能芯片实现设备识别、功率调节等功能，未来还将向联网化延伸，可实现远程监控、智能调节，为用户提供更便捷智能的充电体验；此外，消费电子、智能家居等场景的普及持续拓宽应用边界，人机交互、新型传感、数据融合等技术的发展也将催生更多新兴电子产品，为电源适配器市场带来新的增长机遇。

② 智能手机设备市场

2025年全球智能手机市场逐渐回暖，叠加我国消费电子产品“国补”政策补贴，根据市场研究机构Omdia最新报告显示，2025年全球智能手机市场迎来温和复苏，全年出货量达12.5亿部，同比增长2%，创下2021年以来年度出货量新高。支持快充协议的智能手机设备也需要用到手机端快充协议芯片。目前，快充手机在智能手机市场的渗透率不断上升，已经从高端机型渗透至中低端机型。同时，充电速度更快的快充协议也不断应用于新款智能手机，最新PD3.1快充协议的最大功率已从100W扩大至240W。未来随着AI大模型在手机上的使用，对于智能手机的快速充电功能要求日益提升，这也将推动快充协议芯片在智能手机领域上的发展。

③ 平板电脑、笔记本电脑

随着AIPC的普及，全球平板电脑市场在2025年持续复苏，根据Omdia的最新研究，出货量同比增长9.8%，达到1.62亿台。支持快充功能的平板电脑、笔记本电脑的电源适配器端和设备端都需要使用快充协议芯片，是快充协议芯片的重要应用市场，未来快充协议芯片在该领域的需求有望持续增长。

④ 电动工具

电动工具是快充协议芯片的重要应用市场之一。近年来，随着电钻、电动螺丝刀、冲击扳手等电动工具小型化、便携化的趋势，无绳类充电电动工具逐渐获得推广。支持快充功能的无绳电动工具的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片，这为快充协议芯片在电动工具领域的应用提供了广阔的市场前景。

⑤ 智能家居设备市场

内置锂电池的智能音箱、智能灯、智能小家电等智能家居设备也是快充协议芯片的重要应用领域。支持快充功能的智能家居设备的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片，随着智能家居市场不断优化升级，智能家居概念的普及和消费者对智能化生活的需求增加，智能家居设备市场迎来新的发展机会。

4) 信号链领域

信号链芯片得益于应用场景广泛，下游需求带来信号链芯片发展新契机。近年来，在下游电子产品整机产量高速增长的带动下，中国信号链芯片市场保持稳定的增长。下游应用领域广阔且相关应用终端发展繁荣，未来强劲的下游需求将是带动整个模拟芯片产业持续增长的动力。

① 高速接口芯片市场

高速传输接口芯片是当代电子系统中承担系统互联、数据传输的核心元器件，随传输技术的发展持续迭代升级。在全球平板、手机、笔电、可穿戴设备、车载显示等市场不断发展下，终端设备数量和传输数据数量高倍增长，推动了传输接口数量和种类的增加和变化，以及信号传输技术的发展换代。随着人工智能、万物物联、智能汽车等领域快速增长，全球流量引来爆发式增长。大量数据的传输与交互，为高速传输接口芯片市场的快速发展提供了有力支撑，也将为高速接口芯片带来广阔的市场空间。

② 智能音频芯片市场

音频功放芯片，是各类音响器材中不可缺少的部分，其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后，产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。随着应用设备的小型化，音频功放芯片逐步向智能化、节能化、高效率等方向突破演进，并通过与算法相结合，提升音频响度、清晰度和立体效果，同时对芯片和设备提供保护。随着手机、音响、车载、可穿戴设备、计算机设备、智能家居等下游应用领域的需求扩张。根据IDC发布，2025年中国蓝牙耳机市场年度报告，全年出货量达12137万台，同比增长6.9%，市场由规模扩张转向结构优化。未来，音频功放芯片行业终端应用景气度向好。

综上所述，电源管理芯片、电池管理芯片、数模混合SoC芯片以及信号链芯片，在各自的应用领域均展现出可持续的发展势头。随着科技的不断进步和市场需求的持续变化，这些芯片领域有望在未来继续保持增长态势，为国产半导体产业的发展注入源源不断的动力，同时也将为众多相关行业的创新升级提供有力支持。无论是在传统产业的数字化转型，还是新兴科技领域的开拓创新中，这些芯片都将发挥不可或缺的重要作用，成为推动全球科技进步的关键力量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,464,429,632.09	2,127,372,885.77	15.84	1,983,660,889.53
归属于上市公司股东的净资产	2,193,388,168.55	1,987,495,239.87	10.36	1,830,418,154.26
营业收入	1,609,228,659.14	1,430,516,298.72	12.49	1,215,775,044.39
利润总额	169,708,209.27	114,812,193.92	47.81	32,564,315.76
归属于上市公司股东的净利润	177,974,383.61	124,250,617.15	43.24	29,373,348.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,208,181.22	110,802,450.40	46.39	15,640,087.97
经营活动产生的现金流量净额	27,420,497.61	233,896,798.98	-88.28	38,090,179.23
加权平均净资产收益率（%）	8.58	6.60	增加1.98个百分点	1.66
基本每股收益（元／股）	0.41	0.29	41.38	0.07
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.29	41.38	0.07
研发投入占营业收入的比例（%）	19.74	21.15	减少1.41个百分点	25.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	306,235,794.20	395,466,588.44	467,131,285.82	440,394,990.68
归属于上市公司股东的净利润	19,639,064.92	32,282,379.55	62,535,752.69	63,517,186.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,866,556.21	29,668,892.35	60,248,138.18	59,424,594.48
经营活动产生的现金流量净额	5,583,009.34	43,112,936.84	-21,757,414.12	481,965.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	16,774
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,113
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海英集投资合伙企业（有限合伙）	0	104,535,837	24.10	0	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	-38,056,206	66,132,579	15.25	0	无	0	其他
上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	38,056,206	38,056,206	8.77	0	无	0	其他
北京芯动能投资基金（有限合伙）	-12,450,610	20,764,312	4.79	0	无	0	其他
珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）	0	14,341,554	3.31	0	无	0	其他
上海科技创业投资有限公司	0	7,069,470	1.63	0	无	0	国有法人
成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0	6,925,208	1.60	0	无	0	其他
共青城科苑股权投资合伙企业（有限合伙）	-7,943,112	5,220,000	1.20	0	无	0	其他
黄洪伟	120,000	4,959,433	1.14	0	无	0	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司－兴益传统10号	4,837,610	4,837,610	1.12	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）、成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系，其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄洪伟； 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，其基金管理人均为仟品（上海）股权投资管理有限公司。 除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

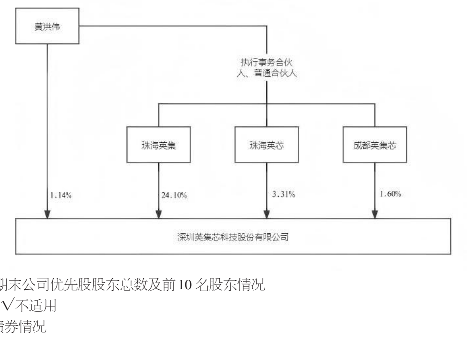
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,609,228,659.14元，较上年同期增长12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润177,974,383.61元，较上年同期增长43.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,208,181.22元，较上年同期增长46.39%。

报告期末，公司总资产2,464,429,632.09元，较上年度末增长15.84%；归属于上市公司股东的净资产2,193,388,168.55元，较上年度末增长10.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-014

深圳英集芯科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	修订	是否提交股东会审议
1	《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《公司内部审计制度》	修订	否

上述修订的治理制度中已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。上述治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年4月28日